

行业周报

电子元器件行业

(20111128—1202)

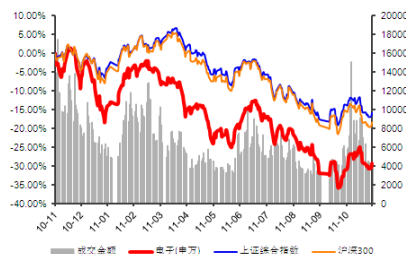
评级: 推荐 维持

低成本智能手机需求增长强劲

市场数据:

上证指数	2360.66
一周涨跌幅	-0.82%
沪深 300 指数	2557.31
一周涨跌幅	-0.49%
申万电子指数	1436.80
一周涨跌幅	-3.56%

相对市场表现:



摘要:

● **电子行业一周表现。** 大盘沪深 300 指数本周下跌 0.49%，电子元器件（申万一级）指数下跌 3.56%，跑输大盘 3.06 个百分点。截止至 12 月 2 日全部 A 股的 TTM 剔除负值后的估值为 13.38 倍，电子行业的 TTM 剔除负值后的估值为 37.23 倍，估值相比上周进一步下降。

在上一周的区间行情中，各行业板块大部分处于下跌状态，大部分行业区间跌幅在 2.23-3.84% 左右，用算术平均方法计算一周成分区间涨跌幅，其中 SW 医药生物板块跌幅最小为 0.42%，而 SW 信息服务板块区间跌幅最大达到 4.91%，SW 电子板块区间跌幅为 3.96%。电子子板块中，SW 半导体材料子行业的区间跌幅最小，近 1.88%，SW 集成电路子行业的区间跌幅最大，为 6.42%。

● **行业全球表现。** 上周(11 月 28 日-12 月 2 日)全球主要资本市场，费城半导体指数 SOX 收于 375.31 点，涨跌幅为 9.06%。道琼斯工业平均指数 DJI 收于 12,020.03 点，涨跌幅为 7.02%。台湾科技指数 TWIT 收于 5,601.46 点，涨跌幅为 7.42%。恒生资讯科技行业指数 HSITSI 收于 2,086.30 点，涨跌幅为 4.93%。

● **华强北电子市场价格一周指数。** 本期华强北电子市场综合指数报点 95.11 点，下跌 0.05 点，跌幅 0.05%。综合指数本周略有下降。

● **据尚普咨询发布的《中国新型电子元器件市场调研报告(2011 版)》显示：在电子元器件产业中，连接器与智能手机周边产业增长速度最为快速。而当前增长最快的智能手机，平板电脑等电子产品，预估在 2012 年会进入高速增长期。这些新产品的专用电子元器件将会迎来市场机遇。尤其是触摸屏、hdi 电路板、柔性电路板、MEMS 传感器等元器件。**

● **根据“十二五”规划，我国将重点促进信息化和工业化深度融合，加强和创新信息化在各个领域内的应用。** 而金融领域、电信领域、政府领域、医疗领域、交通领域及云计算等产业需求为电子元器件行业带来了无限的发展空间。

● **半导体封装测试是全球半导体企业最早向中国转移的产业。** 近几年来，中国封装测试企业快速成长，国外半导体公司也向中国大举转移封装测试产能，封测业务外包已成为国际 IC 大厂的必然选择，从 2007 年至今已有 10 多家 IDM 企业的封测工厂关闭，中国的半导体封装测试行业充满生机。面临着良好的发展机遇。

● **投资建议：** 随着移动互联网的快速增长，建议继续关注移动互联网产业智能手机及平板电脑产业链中触摸屏、连接器、电声器件概念的个股，如长信科技、长盈精密、歌尔声学，以及受益节能环保产业的 LED 行业的 LED 照明企业，如士兰微、鸿利光电、阳光照明等。维持行业评级。

电子元器件研究小组

证书编号 S0120511030002

联系人

许俊

8621-68761616-8560

xujun@tebon.com.cn

德邦证券有限责任公司

上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼

<http://www.tebon.com.cn>

请务必阅读正文后的免责条款部分

目 录

正文目录

1. 行业一周市场回顾	3
行业指数表现:	3
全球电子行业指数:	5
华强北电子市场价格指数:	6
综合指数:	6
电子元器件指数:	6
手机产品价格指数:	7
数码产品价格指数:	8
IT 产品价格指数:	9
2. 全球及国内行业观点	9
3. 公司动态及点评	14
一、行业评级	17
二、股票评级	17

图表目录

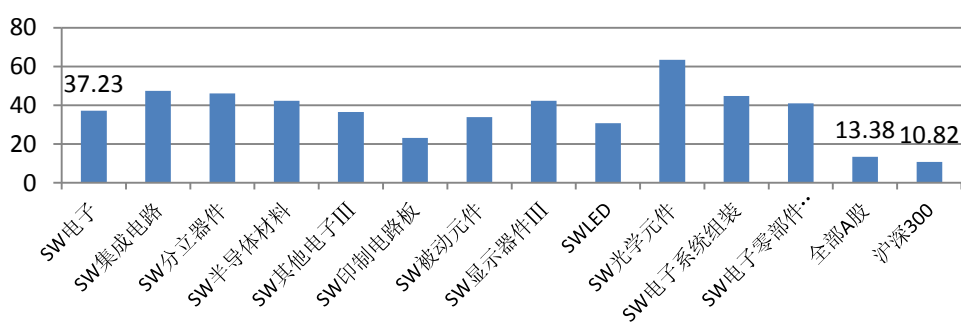
图表 1: 电子行业 PE 与 A 股 PE 比较(TTM,整体法, 剔除负值)	3
图表 2: 沪深 300 与电子指数情况 (申万一级行业电子指数)	3
图表 3: 各行业板块一周区间涨跌幅 (算数平均)	4
图表 4: 电子行业子板块一周区间涨跌幅 (算数平均)	4
图表 5: 行业一周涨幅/跌幅前 5 名公司	5
图表 6: 本周全球电子行业指数	5
图表 7: 华强北电子市场价格指数综合指数走势	6
图表 8: 华强北电子市场---电子元器件价格指数	7
图表 9: 华强北电子市场---手机产品价格指数	8
图表 10: 华强北电子市场---数码产品价格指数	8
图表 11: 华强北电子市场---IT 产品价格指数	9

1. 行业一周市场回顾

行业指数表现：

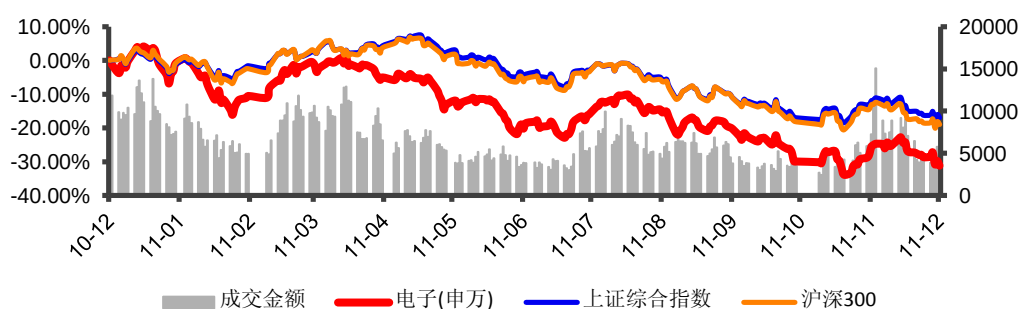
大盘沪深 300 指数本周下跌 0.49%，电子元器件（申万一级）指数下跌 3.56%，跑输大盘 3.06 个百分点。截止至 12 月 2 日全部 A 股的 TTM 剔除负值后的估值为 13.38 倍，电子行业的 TTM 剔除负值后的估值为 37.23 倍，估值相比上周进一步下降。

图表 1：电子行业 PE 与 A 股 PE 比较(TTM,整体法，剔除负值)



资料来源：WIND、德邦证券研究所

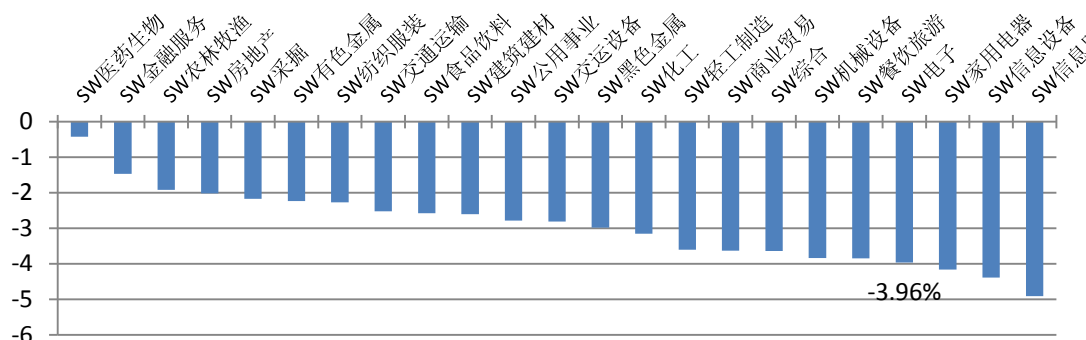
图表 2：沪深 300 与电子指数情况（申万一级行业电子指数）



资料来源：WIND、德邦证券研究所

在上一周的区间行情中，各行业板块大部分处于下跌状态，大部分行业区间跌幅在 2.23-3.84% 左右，用算术平均方法计算一周成分区间涨跌幅，其中 SW 医药生物板块跌幅最小为 0.42%，而 SW 信息服务板块区间跌幅最大达到 4.91%，SW 电子板块区间跌幅为 3.96%。

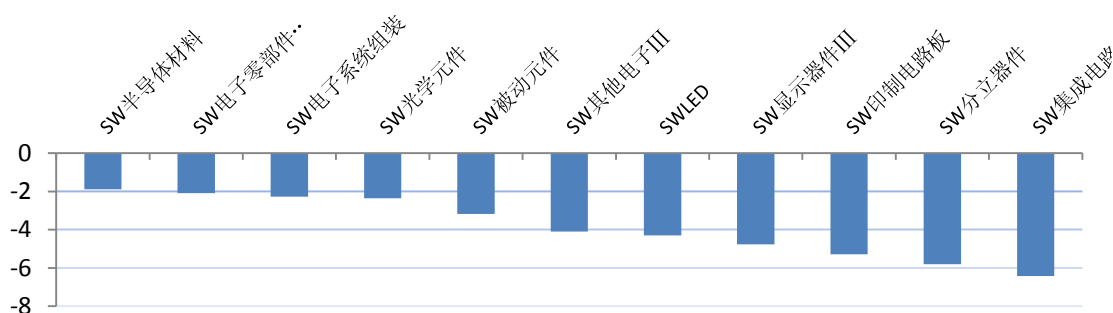
图表 3：各行业板块一周区间涨跌幅（算术平均）



资料来源：WIND、德邦证券研究所

电子子板块中，SW 半导体材料子行业的区间跌幅最小，近 1.88%，SW 集成电路子行业的区间跌幅最大，为 6.42%。

图表 4：电子行业子板块一周区间涨跌幅（算术平均）



资料来源：WIND、德邦证券研究所

图表 5：行业一周涨幅/跌幅前 5 家公司

代码	证券简称	一周涨跌幅	代码	证券简称	一周涨跌幅
002129.SZ	中环股份	7.4%	002106.SZ	莱宝高科	-10.8%
000413.SZ	宝石 A	6.8%	000727.SZ	华东科技	-10.7%
002547.SZ	春兴精工	6.4%	300076.SZ	宁波 GQY	-10.4%
000925.SZ	众合机电	5.8%	300184.SZ	力源信息	-9.9%
300111.SZ	向日葵	5.7%	300232.SZ	洲明科技	-9.6%

资料来源：WIND、德邦证券研究所

全球电子行业指数：

上周(11月28日-12月2日)全球主要资本市场，费城半导体指数 SOX 收于 375.31 点，涨跌幅为 9.06%。纳斯达克综合指数 IXIC 收于 2,626.20 点，涨跌幅为 7.56%。道琼斯工业平均指数 DJI 收于 12,020.03 点，涨跌幅为 7.02%。台湾科技指数 TWIT 收于 5,601.46 点，涨跌幅为 7.42%。台湾加权指数 TWII 收于 7,178.69 点，涨跌幅为 5.81%。恒生指数 HSI 收于 19,002.26 点，涨跌幅为 7.42%。恒生资讯科技行业指数 HSITSI 收于 2,086.30 点，涨跌幅为 4.93%。日经 N225 指数收于 8,643.75 点，涨跌幅为 5.93%。韩国综合指数 KS11 收于 1,910.50 点，涨跌幅为 7.55%。

图表 6：本周全球电子行业指数

指数名称及简称		12月2日收盘价	周涨跌幅
费城半导体	SOX	375.31	9.06%
纳斯达克综合指数	IXIC	2,626.20	7.56%
道琼斯工业平均指数	DJI	12,020.03	7.02%
台湾加权指数	TWII	7,178.69	5.81%
台湾科技指数	TWIT	5,601.46	7.42%
恒生指数	HSI	19,002.26	7.42%
恒生资讯科技行业指数	HSITSI	2,086.30	4.93%
日经指数	N225	8,643.75	5.93%
韩国综合指数	KS11	1,910.50	7.55%

资料来源：WIND、德邦证券研究所

华强北电子市场价格指数:

本期华强北电子市场综合指数报点 95.11 点，下跌 0.05 点，跌幅 0.05%。

综合指数:

本期综合指数本期相当平稳，旗下四板块涨跌互现。其中数码产品呈小幅上涨，幅度为 0.82%；电子元器件、手机和 IT 产品均呈小幅下跌趋势，跌幅分别为 0.09%、0.57% 和 0.12%。从 61 项细分指数类别来看，价格指数波动涨跌幅在 $\pm 1\%$ 以上的品种有所增加，其中车载适配器、电源电路、多功能一体机、机箱、CPU、内存和路由器，涨幅在 2% 以上，车载适配器以 6.67% 的涨幅位居第一。另外 PS PC、平板电脑、芯片跌幅较明显，跌幅分别为 4.35%、3.81%、3.32%。

图表 7：华强北电子市场价格指数综合指数走势



资料来源：华强北、德邦证券研究所

电子元器件指数:

本期电子元器件价格指数报点 101.76 点，下跌 0.09 点，跌幅进一步收窄，为 0.09%，电子元件价格指数继上期大跌 3.07% 后，本期继续下挫，但跌幅收缩至 0.58%。电阻器、电容器和电感器等均继续下跌，电阻器跌幅 1.35% 位列第一。值得注意的是，滤波器逆

转上周跌势，本周取得 1.03% 的涨幅。

电子器件指数止升回落，本期下跌 0.07%。主要由于集成电路下跌所致，本期集成电路价格指数比上期下跌 0.06%，其中芯片和 DSP 跌势凶猛，跌幅分别到达 3.32% 和 1.41%。但其中也有部分品种呈现明显涨势，例如电源电路和数字电路分别上涨 3.14% 和 1.02%。分立器件本期继续上涨，幅度为 0.25%。二极管和三极管均持上扬态势，幅度差别不大，分别是 0.29% 和 0.22%。

图表 8：华强北电子市场---电子元器件价格指数



资料来源：华强北、德邦证券研究所

手机产品价格指数：

本期手机价格指数报点 79.57 点，下跌 0.46 点，涨幅 0.57%。手机产品指数重新步入跌势，主要受到国外品牌手机拖累，本期国外品牌手机价格指数下跌了 2.02 点，跌幅 2.59%。Iphone 是本周唯一呈上涨态势的品牌，其余品牌表现均较为差劲，特别是索尼-爱立信由上周的 76.10 点跌至 68.68 点，价格指数下跌了近 8 个百分点。由此可见苹果品牌在当今市场的强势，也反映出整个产品线更新换代速度之快以及市场竞争之激烈。而国内品牌手机价格指数则有小幅回升，本期上涨了 0.33 点，涨幅 0.41%，主要得益于华为、酷派等低端智能手机领跑品牌的强势。

图表 9：华强北电子市场---手机产品价格指数



资料来源：华强北、德邦证券研究所

数码产品价格指数：

本期数码产品价格指数报点 88.8 点，上涨 0.72 点，上涨 0.82%。本期数码产品中，移动存储设备、数码相机、MP3、数码摄像机等均呈现一致上涨的态势，其中移动存储设备涨幅最大，达到 2.67%，数码相机和 MP3 涨幅也均达到 1%以上；此外，也有四个细分类价格呈下跌的走势，分别是网络摄像机、MP4、车载 GPS、摄像头，跌幅分别是 2.48%、2.29%、1.04%和 0.42%。

图表 10：华强北电子市场---数码产品价格指数



资料来源：华强北、德邦证券研究所

IT 产品价格指数:

本期 IT 产品价格指数报点 90.81 点，小幅下跌 0.43 点，跌幅 0.12%。从 IT 产品的五大分类来看，本期除了整机部分价格指数有所回落，外部设备、网络设备、电脑配件和电源价格指数均实现上涨。整机中，平板电脑领跌三大细分品种，跌幅达到 3.81%，此外笔记本和台式 PC 均呈下跌走势，跌幅分别为 1.22% 和 0.51%。外部设备本期小幅上涨 0.12%，其中打印机、多功能一体机和扫描仪分别上涨 0.76%、2.77% 和 0.87%；而电脑显示器及 PS PC 下跌，电脑显示器跌幅 0.55%，尤其是 PS PC 跌幅最大，达到 4.35%。网络设备中交换机和网卡延续跌势，跌幅分别是 1.19% 和 1.21%，而路由器本周逆势上涨 2%。电脑配件近期持续上涨，目前市场关注度最高的硬盘却出现久违的下跌走势，本期下跌 1.56 点，跌幅 1.36%。此外还有电脑音箱下跌，电脑配件其它产品均上涨，涨势较明显的电脑 CPU 涨幅达到 2.31%。电源产品中车载逆变器下跌 0.67%，车载适配器和电脑电源价格指数均实现回升。

图表 11：华强北电子市场---IT 产品价格指数



资料来源：华强北、德邦证券研究所

2. 全球及国内行业观点

● 电子元器件行业发展巨大

电子技术发展十分迅速，应用十分广泛，已经成为近代科学技术发展的一个重要标志。电子元器件发展史更是一部浓缩的电子发展史，而在短期内电子元器件公司有望实现数倍成长。

电子元器件主要应用于 3c 产品中。2010 年,电脑对电子元器件的需求占比为 42.1%,通讯设备占比为 22.6%,消费电子占比为 23.4%。2011 年第 3 季度电子行业固定资产 663.81 亿元,同比增 41.73%。电子行业仍处在快速扩张中态势中。

尚普咨询电子行业分析师指出:国内电子元器件虽然本身核心技术比较缺乏、没有控制产业链的能力,相对处于劣势。但国内电子元器件产业受益与下游电子产品生产基地和受益于全球产能转移发展十分迅速,产值增速超过全球平均水平。电子元器件的应用领域主要集中在 pc、手机、消费电子,还有少部分用于工业、通讯设备以及汽车电子等领域,其市场需求比较大成长空间也比较大。

据尚普咨询发布的《中国新型电子元器件市场调研报告(2011 版)》显示:在电子元器件产业中,连接器与智能手机周边产业增长速度最为快速。而当前增长最快的智能手机,平板电脑等电子产品,预估在 2012 年会进入高速增长期。这些新产品的专用电子元器件将会迎来市场机遇。尤其是触摸屏、hdi 电路板、柔性电路板、mems 传感器等元器件。根据“十二五”规划,我国将重点促进信息化和工业化深度融合,加强和创新信息化在各个领域内的应用。而金融领域、电信领域、政府领域、医疗领域、交通领域及云计算等产业需求为电子元器件行业带来了无限的发展空间。

● 高集成度芯片是满足低成本智能手机需求的关键---来自:国际电子商情

硅片集成度将是帮助智能手机实现差异化的关键因素。在低成本手机增长需求的推动下,2014 年智能手机将达到 6 亿部。“未来 3 亿部智能手机将来自多功能手机更换,”市场研究公司 Linley Group 的首席分析师 Linley Gwennap 表示,“智能手机设计者面临的压力将是降低系统成本,以满足这种对低成本智能手机日益增长的需求,而关键在于芯片集成。”

大部分这方面的集成是将应用处理器与基带处理器组合在一起。Gwennap 预测,到 2014 年,将近 70%的智能手机将采用此类集成芯片。如果设计师想实现主打新兴市场的 100 美元智能手机,上述集成芯片将是关键。与此同时,Gwennap 表示,你可以利用独立的应用处理器与基带处理器满足的智能手机市场正在缓慢减小到大约每年 8000 万至 1 亿部。

“我们完全相信,多数增长将来自集成芯片,”高通的一名资深经理 Raj Talluri 表示,“我们对智能手机的不同市场消费群进行过一些分析,我们发现该市场 50%以上属于成本

低于 150 美元的手机，而且这个群体正在不断扩大。”Talluri 补充道：“当你想进入这个市场消费群体时，材料清单(BOM)不允许你采用独立的应用处理器与 modem 处理器。”

LG、摩托罗拉和三星都是最大的多功能手机厂商，因此最能抓住下一轮智能手机增长所带来的机会。Gwennap 表示，高通和 Marvell 引领集成式应用与基带处理器潮流，而博通和 ST Ericsson 则拥有下一代集成芯片所需的元件。

他说，高通的四芯片智能手机芯片组，将在 2012 年整合为三芯片方案，分别为数字、RF 与模拟功能。不过，大多数的智能手机集成芯片，可能实际上还是采用将多颗裸晶封装在一起的方式。

在应用处理器方面，今年双核产品可说是横扫智能手机应用市场；英伟达(Nvidia)以 Tegra 2 处理器引领潮流，该芯片已经应用在 LG 的智能手机与 Motorola 的平板产品中。Gwennap 预期，今年还将有其它六款来自各芯片大厂的双核手机应用处理器进驻新系统。英伟达在今年 2 月份展示了它的新一代四核 Tegra 3，飞思卡尔与高通也已宣布将推出类似的产品。“初期的部分四核设计的发热温度会超出智能手机的限制，因此需要限制其运行速度，这样的话就达不到预期性能，”Gwennap 表示，“因此，四核芯片一开始会在平板电脑平台上获得成功，因为该类系统的散热较佳。”他说，四核芯片要到 28 纳米工艺的版本才适合智能手机应用。“四核本身不是问题，问题在于如何使用那些核心，”高通的 Talluri 表示。他强调，该公司的芯片能控制每个独立核心的频率。“我们的四核处理器芯片会采用 28 纳米工艺，而且大部分散热管理问题跟芯片封装技术有关，即你如何堆叠记忆体或是否采用硅通孔。”

ARM 则表示已花费不少时间开发“快速进入闲置(rush to idle)”技术，让处理器芯片能快点完成任务然后去“睡觉”。

市场研究公司 Linley Group 首席分析师 Linley Gwennap“当芯片全速运转时，还是会消耗大量功率，而这正是发生过热问题的时候，”Gwennap 指出。“在接下来一至两年，英伟达与高通将在应用处理器性能表现方面争夺领先地位；德州仪器则几乎从没达到过那个境界，”Gwennap 表示，“博通的目标是较低性能的主流平板市场，以及多功能手机换机市场，并非高端市场，(因为)在这个市场你不一定非要成为性能领先者。”Gwennap 表示，英特尔未来有可能在智能手机市场找到一个虽然小但很重要的据点。他说：“到 2014 年，我们预期英特尔应该能以先进工艺技术推出具有相当竞争力的产品，可能被少量的智能手机采用，但他们在创造软件生态系统方面存在很大障碍。”

移动 3D 图形芯片也在今年迅速由双核升级至四核，不过 Gwennap 指出，测量移动图形处理器的原始性能仍是一项挑战，他呼吁业界订定移动图形芯片的性能基准。Gwennap 补充指出，配备新款视频引擎的硬件，将能帮助处理两个 24 帧/秒的 1080p 视频流以获得 3D 效果，或是 60 帧/秒的视频以获得高画质。他说，要在低功耗的条件下完成这样的任务，将要求视频引擎直接访问系统内存，不经过主 CPU。

● 浙江省前 10 个月电子信息产业增势趋稳——来自：信息通信导报

11 月 24 日，浙江省经信委召开了全省电子信息行业经济形势分析会议。据悉，前 10 个月全省电子信息产业运行持续延续上半年以来的良好发展态势，总体上仍在较快增长平台上运行。

前 10 个月，全省电子信息制造业经济效益增幅好于全国电子行业平均水平，利润始终保持两位数增长。软件行业今年的发展增势较快。前 10 个月的收入规模接近 700 亿元，提早两个月实现了去年全年的收入，其增速高于全国软件收入增速。这与浙江省不断推动软件产业创新融合发展密切相关，使得软件产业进入了快速发展的新阶段。其中，一批龙头骨干企业如阿里巴巴、华三通信、海康威视、网新科技、恒生电子、大华股份、中控科技的带动作用显得尤为突出。前 10 个月软件十强企业实现软件收入 348 亿元，利润总额 118.9 亿元，其收入占全省软件收入的 50.4% 和 72.7%。截止到 10 月份，全省软件收入超亿元的企业已达 82 家，其中 10 家企业超 10 亿元。

总体来看，浙江省电子信息行业在经济运行中仍保持较快增长，这主要得益于技术创新引领增长，助推产业转型升级；投资明显加快，引领行业可持续发展；龙头骨干企业带动明显。但是由于国际形势变化、通胀矛盾突出、宏观政策趋紧、要素制约明显等多种因素互相叠加的影响，浙江省电子信息产业也面临着出口增速逐月回落，企业生产成本居高不下，经济运行下行压力增加的问题。

● 封装将成中国半导体产业的重心

据来自电子元件技术网消息。仔细分析半导体产业链上下游各个工艺，各个环节之间的行业特征越来越明显，差异越来越大。首先看轻资产的芯片设计(Fabless)业务，这是一个高度技术密集的产业。欧美、日本企业经过几十年的技术积累，现在已经基本把芯片设计的核心技术掌握在手中，并且建立了垄断的态势。

再来看晶圆制造(Foundry)业务,这是一个资本和技术密集产业,但以资本密集为主。晶圆厂的关键设备-光刻机的价格在千万美元到亿美金级别,一个晶圆工厂的投资现在是以十亿美金的规模来计划。

同时,从技术的角度来看,未来摩尔定律持续推进的难度日益增加,研发费用也必然逐步上升。以台积电 TSMC 为例,在过去五年研发人员扩充三倍,同一期间研发支出增加两倍强。其最重要的原因就是摩尔定律接近极限而导致的技术开发难度加大。摩尔定律预测半导体的集成度每 18 个月就翻番。回顾历史,摩尔定律是正确的,集成电路的线宽已经微米级别发展到纳米级别。同时晶圆制造技术的升级换代也加快,从微米级别加速进步到纳米级别,从 90nm 到 65nm 到目前 CPU 普遍采用的 45nm 技术的更新时间间隔缩短,目前正在开展 20nm 级别的制程研究中。但是现在,光学显影的方法已经发展到了极限,很难再进一步缩减晶片尺寸。未来,将需要转换到非光学显影的方法,这意味着更高的成本。

根据 InternatiONalBusinessStrategies(IBS)公司的分析,随着摩尔定律的发展,芯片集成度的提高和线宽的减小,全球晶圆企业中能够提供相应技术的公司数目由 0.13um 技术时代的 15 家萎缩到 45 纳米技术时代的 9 家。IBS 预计在 32 纳米和 22 纳米时代将分别只剩下 5 家和 3 家公司能提供相应技术的晶圆制造服务。“马太效应”将在晶圆制造产业显著体现。

最后再来看芯片封装(Package)行业,这是一个技术和劳动力密集产业,在半导体产业链中是劳动力最密集的。我们参考台湾本土半导体产业链中的联发科、台积电、日月光和矽品的人均创造营收指标,可以看出,专注于技术的 IC 设计行业人均创造营收大约是晶圆制造行业的 3 倍左右,大约是封测行业的 10 倍左右。技术和资本密集的晶圆制造环节人均创造营收大约为芯片封装环节人均创造营收的 3 倍左右。半导体产业这两个中下游的环节在人力成本上具有显著区别。

考虑到中国半导体产业的综合水平,我们认为半导体封装测试环节是最适合中国企业切入全球半导体产业链的。基本逻辑也很明确,芯片设计领域技术壁垒很高,中国目前半导体产业薄弱的技术储备不具备实力去直接抢夺国际大厂商的市场,中国芯片设计企业还只能在一些小行业里从事一些比较初级的开发作业,不具备国际竞争的實力。而在晶圆制造行业,一方面技术更新换代进程加快,另一方面对资金、技术的要求较高,风险较大,行业的“马太效应”明显,目前新企业进入晶圆制造行业的难度不断增大。半导体封装行业是集成电路产业链三层结构中技术要求最低,同时也是劳动力最密集

的一个领域，最适合中国企业借助于相对较低的劳动力优势去切入的半导体产业的。

半导体封装测试是全球半导体企业最早向中国转移的产业。近几年来，中国封装测试企业快速成长，国外半导体公司也向中国大举转移封装测试产能，封测业务外包已成为国际 IC 大厂的必然选择，从 2007 年至今已有 10 多家 IDM 企业的封测工厂关闭，中国的半导体封装测试行业充满生机。封装测试行业已成为中国半导体产业的主体，占据着半壁江山，而且在技术上也开始向国际先进水平靠拢。全球封测产能向中国转移加速，中国封测业市场继续呈增长趋势，半导体封测业面临着良好的发展机遇。

根据中国半导体行业协会的统计，2010 年上半年中国集成电路产量为 302.5 亿块，行业实现销售收入 666 亿元，与 2009 年上半年同期增长 45.1%。其中芯片设计业销售规模达到 128.47 亿元，同比增速 9.8%，芯片制造业销售收入为 209.21 亿元，同比增长 51%，而封装测试也销售收入规模为 328.35 亿元，同比增长 61.4%。根据协会初步统计，2010 年中国集成电路产业销售额为 1424 亿元，其中芯片设计业销售 383 亿元，芯片制造业销售 409 亿元，封装测试行业销售额为 632 亿元。封装测试环节是我国集成电路产业链中相对成熟的环节，其产值一度占据我国集成电路产业总产值的 70%。“近年来，由于我国集成电路设计和芯片制造业的快速发展，封测业所占比例有所下降，但仍然占据我国集成电路产业的半壁江山。随着‘摩尔定律’日益接近其物理极限，业界越来越深刻地认识到，在‘后摩尔定律’时代，封测产业将挑起技术进步的大梁。”反观台湾半导体产业的产值分布是以晶圆制造为重，芯片设计和封装测试并列的局面。

预测未来全球的半导体行业在将呈现很明显的区域特征。欧美和日本的格局是芯片设计>晶圆制造>封装测试，台湾的格局是晶圆制造>芯片设计>封装测试，而中国的格局是封装测试>芯片设计>晶圆制造。

3. 公司动态及点评

- 苹果下一代显示面板消息显示 日本厂商收获多

最新的消息显示，索尼和日立目前正在联手为苹果公司研发全新的 4.0 英寸液晶显示屏面板，而该液晶显示面板将会提供给苹果下一代的 iOS 设备使用。从之前的消息已经了解到索尼和日立将会在明年春季和东芝移动显示器公司进行业务合并共同投资新一代的显示屏面板的产能。

尽管对于该 4.0 英寸的显示屏面板具体将会用于哪一款苹果 iOS 设备目前还没有一个明确的说法，不过业内人士表示新一代的 iPhone 5 智能手机以及新款的 iPod Touch 都有可能使用这种 4.0 英寸的显示屏面板，毕竟要求苹果 iPhone 智能手机显示屏尺寸扩大的呼声是越来越高，而竞争对手谷歌 Android 的智能手机产品目前的主流显示屏尺寸已经达到了 4.3 英寸，这对于依然维持在 3.5 英寸显示屏的苹果 iPhone 而言是有比较大压力的。

另外之前已经有消息称，苹果在夏普公司的龟山第二工厂开始生产 IGZO 材料的液晶面板，这种新型材料的面板能够为苹果未来的新款 iPhone 智能手机和 iPad 平板电脑提供更为出色的显示性能。技术人员透露 IGZO 材料可以为用户提供类似 OLED 的低功耗，而且成本要比 OLED 更低，同时在产品的设计上可以比 OLED 还要薄 25% 左右。

● 士兰微将获得总额为 4976 万元的财政资助资金

士兰微 (600460) 25 日公告，11 月 23 日，公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司 (以下简称士兰明芯) 收到杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2011 年第一批杭州市重点产业 (工业和信息化专项) 发展资金的通知》，士兰明芯的“高亮度 LED 芯片生产线扩产技改”项目将获得总额为 4976 万元的财政资助资金。

● 三星电子将 Dialog 半导体电源管理及音频 IC 用于其基于安卓系统的智能手机

德国 Kirchheim/Teck, 2011 年 11 月 28 日—高集成度和创新的电源管理、音频和近距离无线技术解决方案提供商 Dialog 半导体有限公司 (FWB:DLG) 日前宣布：该公司将向三星公司发售采用系统级封装 (SIP) 的系统级电源管理和低功率音频 IC，将用于三星的 TD-SCDMA S-5368 智能手机。S-5368 面向中国市场并将通过中国最大的移动电话运营商中国移动进行分销。

Dialog 在三星上的成功，主要归因于它是将一片跨平台完全可配置的高度复杂系统电源管理芯片与一片低功率 D 类音频编解码器芯片相结合的第一家公司，其音频编解码器中包括在一个单一封装中的一个数字信号处理器，使其实现了显著的功率及印刷电路板空间节省，同时为三星公司的新智能机提供最高质量的音频。

去年智能机市场的增长率为 44%，并占 2011 年第三季度所有手机销售的 26%。三星售出了 2800 万部智能机，并从数量上看已成为世界最大的智能手机供应商，市场份额为 24%。放眼未来，智能手机在中国的进一步广泛扩散代表着最大的机会，因为曾经占优势的“功能手机”细分市场越来越多地转向更低成本的智能机。

Dialog 的首席执行官 JalalBagherli 说道：“三星生产非常具有吸引力和高雅的智能机，不仅集成了最先进的功能，而且与其基于富有吸引力的市场价格点上的安卓操作系统实现差异化的能力相结合，生产出了一些全世界最受追捧的手机。”“这对于 Dialog 来说是一个意义重大的里程碑，因为我们拓展了在用于智能手机的电源管理芯片和高质量音频方面的领导能力。我们现在期待着今后几个月中在全球推出更多基于这个平台型号，其中包括了现在非常流行的 GalaxyS-II 系列智能机。”Bagherli 补充说道。

分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级

一、行业评级

推荐 – Attractive： 预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数

中性 – In-Line： 预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平

回避 – Cautious： 预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数

二、股票评级

买入 – Buy： 预期未来 6 个月股价涨幅 $\geq 20\%$

增持 – Outperform： 预期未来 6 个月股价涨幅为 $10\%-20\%$

中性 – Neutral： 预期未来 6 个月股价涨幅为 $-10\% - +10\%$

减持 – Sell： 预期未来 6 个月股价跌幅 $>10\%$

特别声明

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对报告中信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归德邦证券有限责任公司所有。未获得德邦证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“德邦证券有限责任公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。